

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一八年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2018 年 11 月 8 日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一八年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創新高，達 2.412 億美元，同比增長 14.9%，環比增長 4.9%。
- 毛利率 34.0%，同比下降 1.2 個百分點，但環比上升 0.4 個百分點。
- 期內溢利 5,090 萬美元，同比上升 44.1%，環比上升 10.9%。
- 基本每股盈利 0.046 美元，同比上升 0.012 美元（或 35.3%），環比上升 0.002 美元（或 4.5%）。
- 淨資產收益率（年化）11.2%，同比上升 2.4 個百分點，環比上升 0.8 個百分點。

二零一八年第四季度指引

- 我們預計銷售收入同比增長 15% ~ 16%，環比增長 3% ~ 4%。
- 我們預計毛利率約為 34%。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第三季度的業績評論道：

“我們第三季度的表現非常強勁！幾乎所有細分市場都有強勁的需求，尤其是 MCU、超級結、IGBT 和通用 MOSFET 領域。銷售收入再創新高，達 2.412 億美元，同比增長 14.9%，環比增長 4.9%。毛利率持續保持穩定，並上升到 34.0%，環比上升 0.4 個百分點，這得益於持續的高產能利用率和不斷優化的產品組合。由此，淨利潤率達到相當可觀的 21.1%。如此卓越的表現祇有通過熱情、奉獻和努力才能實現。”

王煜先生繼續說道，“我們對公司的未來充滿信心。最重要的是，我們堅信我們特色工藝的戰略。當前中美貿易戰和匯率市場的波動基本沒有給我們帶來重大的影響，我們預計今年將強勁收官。同時，我們預期公司將在 2019 年繼續成長。因此，我們正全速推進無錫工廠的建設。目前，我們計劃在明年下半年開始機臺搬入，在 2019 年第四季度開始 300mm 晶圓的生產。我們對這一新項目充滿期待。”

電話會議公告

日期：二零一八年十一月九日（星期五）

時間：下午 04:00（上海 / 香港）
上午 03:00（紐約，2018 年 11 月 9 日，星期五）

發言人：王煜，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~3q_2018_earnings_call

電話詳細：

國際	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名：1990938

密碼：HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。（回放密碼：Huahong）

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	241,222	209,928	229,868	14.9 %	4.9 %
銷售成本	(159,276)	(135,960)	(152,622)	17.1 %	4.4 %
毛利	81,946	73,968	77,246	10.8 %	6.1 %
毛利率	34.0 %	35.2 %	33.6 %	(1.2)	0.4
經營開支	(31,798)	(29,336)	(34,030)	8.4 %	(6.6)%
其他收入淨額	14,320	4,438	16,082	222.7 %	(11.0)%
稅前溢利	64,468	49,070	59,298	31.4 %	8.7 %
所得稅開支	(13,547)	(13,729)	(13,401)	(1.3)%	1.1 %
期內溢利	50,921	35,341	45,897	44.1 %	10.9 %
淨利潤率	21.1 %	16.8 %	20.0 %	4.3	1.1
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	48,300	35,341	45,791	36.7 %	5.5 %
非控股權益	2,621	-	106	-	2,372.6 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.046	0.034	0.044	35.3 %	4.5 %
攤薄	0.046	0.034	0.043	35.3 %	7.0 %
付運晶圓(仟片)	530	477	501	11.1 %	5.8 %
產能利用率 ¹	101.5 %	99.8 %	101.5 %	1.7	-
淨資產收益率 ²	11.2 %	8.8 %	10.4 %	2.4	0.8

二零一八年第三季度

- 銷售收入再創新高，達 2.412 億美元，同比增長 14.9%，環比增長 4.9%。
- 銷售成本 1.593 億美元，同比上升 17.1%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加；環比上升 4.4%，主要由於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 34.0%，同比下降 1.2 個百分點，主要由於折舊成本上升；環比上升 0.4 個百分點，主要得益於產品組合優化。
- 經營開支 3,180 萬美元，同比上升 8.4%，主要由於人工費用和專業服務費用上升；環比下降 6.6%，主要由於在上一季度計提了設備減值準備。
- 其他收入淨額 1,430 萬美元，同比上升 222.7%，主要由於(i)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，(ii) 本季度取得匯兌收益，上年同期為匯兌損失；環比下降 11.0%，主要由於分佔一家聯營公司溢利減少，部分被公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益增加所抵消。
- 所得稅開支 1,350 萬美元，與前期均持平。
- 期內溢利 5,090 萬美元，同比上升 44.1%，環比上升 10.9%。
- 淨利潤率 21.1%，同比上升 4.3 個百分點，環比上升 1.1 個百分點。
- 基本每股盈利 0.046 美元，同比上升 0.012 美元（或 35.3%），環比上升 0.002 美元（或 4.5%）。
- 淨資產收益率（年化）11.2%，同比上升 2.4 個百分點，環比上升 0.8 個百分點。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	236,125	97.9 %	204,516	97.4 %	31,609	15.5 %
其他	5,097	2.1 %	5,412	2.6 %	(315)	(5.8)%
銷售收入總額	241,222	100.0 %	209,928	100.0 %	31,294	14.9 %

- 本季度 97.9% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	137,615	57.1 %	116,530	55.6 %	21,085	18.1 %
美國	40,109	16.6 %	37,887	18.0 %	2,222	5.9 %
亞洲 ⁴	30,655	12.7 %	26,281	12.5 %	4,374	16.6 %
歐洲	18,607	7.7 %	14,573	6.9 %	4,034	27.7 %
日本 ⁵	14,236	5.9 %	14,657	7.0 %	(421)	(2.9)%
銷售收入總額	241,222	100.0 %	209,928	100.0 %	31,294	14.9 %

- 本季度來自中國的銷售收入 1.376 億美元，占銷售收入總額的 57.1%，同比增長 18.1%，主要得益於通用 MOSFET、智能卡芯片、IGBT 和超級結產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 4,010 萬美元，同比增長 5.9%，主要得益於通用 MOSFET 和超級結產品的需求增加，部分被邏輯產品的需求減少所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,070 萬美元，同比增長 16.6%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,860 萬美元，同比增長 27.7%，主要得益於通用 MOSFET 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,420 萬美元，同比減少 2.9%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	89,571	37.1 %	75,832	36.1 %	13,739	18.1 %
分立器件	81,432	33.8 %	57,872	27.6 %	23,560	40.7 %
模擬與電源管理	37,813	15.7 %	39,761	18.9 %	(1,948)	(4.9)%
邏輯及射頻	26,052	10.8 %	28,471	13.6 %	(2,419)	(8.5)%
獨立非易失性存儲器	6,268	2.6 %	7,600	3.6 %	(1,332)	(17.5)%
其他	86	-	392	0.2 %	(306)	(78.1)%
銷售收入總額	241,222	100.0 %	209,928	100.0 %	31,294	14.9 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,960 萬美元，同比增長 18.1%，主要得益於智能卡芯片和 MCU 的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 8,140 萬美元，同比增長 40.7%，主要得益於通用 MOSFET、IGBT 和超級結產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,780 萬美元，同比減少 4.9%，主要由於 LED 照明和模擬產品的需求減少，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,610 萬美元，同比減少 8.5%，主要由於邏輯產品的需求減少，部分被射頻產品的需求增加所抵消。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 630 萬美元，同比減少 17.5%，主要由於閃存和 MCU 產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13μm 及以下	82,458	34.2 %	69,559	33.1 %	12,899	18.5 %
0.15μm 及 0.18μm	35,178	14.6 %	39,462	18.8 %	(4,284)	(10.9)%
0.25μm	3,790	1.6 %	3,744	1.8 %	46	1.2 %
0.35μm 及以上	119,796	49.6 %	97,163	46.3 %	22,633	23.3 %
銷售收入總額	241,222	100.0 %	209,928	100.0 %	31,294	14.9 %

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,250 萬美元，同比增長 18.5%，主要得益於智能卡芯片和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,520 萬美元，同比減少 10.9%，主要由於模擬和邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 380 萬美元，同比持平。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.198 億美元，同比增長 23.3%，主要得益於通用 MOSFET、IGBT 和超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	156,590	64.9 %	144,402	68.8 %	12,188	8.4 %
工業及汽車	48,497	20.1 %	28,879	13.8 %	19,618	67.9 %
通訊	24,587	10.2 %	26,089	12.4 %	(1,502)	(5.8)%
計算機	11,548	4.8 %	10,558	5.0 %	990	9.4 %
銷售收入總額	241,222	100.0 %	209,928	100.0 %	31,294	14.9 %

- 本季度電子消費品仍然是我們第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.566 億美元，占銷售收入總額的 64.9%，同比增長 8.4%，主要得益于通用 MOSFET 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 4,850 萬美元，同比增長 67.9%，主要得益于 MCU、IGBT、智能卡芯片、通用 MOSFET 和超級結產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,460 萬美元，同比減少 5.8%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,150 萬美元，同比增長 9.4%，主要得益于通用 MOSFET 和邏輯產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	63	65
2 號晶圓廠	59	57	59
3 號晶圓廠	48	46	48
合計	172	166	172
產能利用率	101.5%	99.8%	101.5%

- 得益于客戶需求的增加，本季度產能利用率達 101.5%，同比上升 1.7 個百分點。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	530	477	501	11.1 %	5.8 %

- 本季度付運晶圓 530,000 片，同比增加 11.1%，主要由於客戶需求的增加。

經營開支分析

以千美元計	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,025	1,826	1,963	10.9 %	3.2 %
管理費用 ⁷	29,773	27,510	32,067	8.2 %	(7.2)%
經營開支	31,798	29,336	34,030	8.4 %	(6.6)%

- 經營開支 3,180 萬美元，同比上升 8.4%，主要由於人工費用和專業服務費用上升；環比下降 6.6%，主要由於在上一季度計提了設備減值準備。

其他收入淨額

以千美元計	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,253	3,607	3,433	(9.8)%	(5.2) %
利息收入	1,356	1,819	2,057	(25.5)%	(34.1)%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	7,196	-	1,787	-	302.7 %
匯兌收益/(損失)	1,086	(3,235)	1,731	(133.6)%	(37.3)%
分佔一家聯營公司溢利	453	1,248	4,708	(63.7)%	(90.4)%
財務費用	(487)	(557)	(690)	(12.6)%	(29.4)%
政府補貼	979	1,429	2,726	(31.5)%	(64.1)%
其他	484	127	330	281.1 %	46.7 %
其他收入淨額	14,320	4,438	16,082	222.7 %	(11.0)%

- 其他收入淨額 1,430 萬美元，同比上升 222.7%，主要由於(i)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，(ii) 本季度取得匯兌收益，上年同期為匯兌損失；環比下降 11.0%，主要由於分佔一家聯營公司溢利減少，部分被公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益增加所抵消。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	72,969	75,394	51,953	(3.2)%	40.5 %
投資活動所用現金流量淨額	(600,214)	(76,675)	(155,088)	682.8 %	287.0 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	140	(556)	333,523	(125.2)%	(100.0)%
外匯匯率變動影響淨額	(25,337)	4,253	(11,327)	(695.7)%	123.7 %
現金及現金等價物變動影響淨額	(552,442)	2,416	219,061	(22,966.0)%	(352.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 7,300 萬美元，同比下降 3.2%，主要由於材料和經營開支的付款增加，大部分被貿易應收款項及應收票據的回收增加所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 6.002 億美元，其中包括(i)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資支出 5.927 億美元，(ii)設備投資支出 6,200 萬美元，部分被(a)收回定期存款投資 4,970 萬美元，及(b)收到利息收入 4.8 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 10 萬美元，其中包括因股票期權行權而增發股份收到的投資款 60 萬美元，部分被支付利息 50 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)
資產總額	2,641,156	2,670,444
負債總額	396,359	389,174
所有者權益總額	2,244,797	2,281,270
資產負債率 ⁸	15.0%	14.6%

資本開支

以千美元計	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)
華虹宏力	33,764	25,768
華虹無錫	28,263	3,117
合計	62,027	28,885

- 本季度資本開支 6,200 萬美元，其中 2,830 萬美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)
存貨	132,924	127,997
貿易應收款項及應收票據	124,932	121,528
預付款項、按金及其他應收款項	7,185	11,346
應收關聯方款項	50,228	51,496
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	775,311	190,134
已凍結存款及定期存款	340	64,069
現金及現金等價物	284,280	836,722
流動資產總額	1,375,200	1,403,292
貿易應付款項	68,632	66,561
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	140,159	143,445
計息銀行借款	60,521	60,694
政府補助	43,722	42,205
應付關聯方款項	14,868	19,055
應付所得稅	27,015	18,888
流動負債總額	354,917	350,848
淨營運資金	1,020,283	1,052,444
速動比率	3.5x	3.6x
流動比率	3.9x	4.0x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	51	54
存貨周轉天數	74	76

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,130 萬美元下降至本季度末的 720 萬美元，主要由於對供應商的預付款減少。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 1.901 億美元上升至本季度末的 7.753 億美元，主要由於購買銀行理財產品。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 6,410 萬美元下降至本季度末的 30 萬美元，主要由於收回定期存款投資。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,910 萬美元下降至本季度末的 1,490 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 1,890 萬美元上升至本季度末的 2,700 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 10.203 億美元，流動比率 3.9。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 51 天。
- 本季度存貨周轉天數為 74 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)
銷售收入	241,222	209,928	229,868
銷售成本	(159,276)	(135,960)	(152,622)
毛利	81,946	73,968	77,246
其他收入及收益	14,354	7,049	12,530
銷售及分銷費用	(2,025)	(1,826)	(1,963)
管理費用	(29,773)	(27,510)	(32,067)
其他費用	-	(3,302)	(466)
財務費用	(487)	(557)	(690)
分佔一家聯營公司溢利	453	1,248	4,708
稅前溢利	64,468	49,070	59,298
所得稅開支	(13,547)	(13,729)	(13,401)
期內溢利	50,921	35,341	45,897
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	48,300	35,341	45,791
非控股權益	2,621	-	106
持有人應佔每股盈利			
基本	0.046	0.034	0.044
攤薄	0.046	0.034	0.043
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,040,919,943	1,034,043,768	1,039,907,108
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,054,748,943	1,043,395,768	1,052,787,108

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	751,971	727,636	737,713
投資物業	170,579	177,349	176,718
預付土地租賃款項	59,012	61,521	20,481
無形資產	5,877	6,693	8,002
於聯營公司的投資	60,015	61,928	48,258
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	207,925	216,177	212,524
長期預付款項	3,466	8,016	2,801
遞延稅項資產	7,111	7,832	7,364
非流動資產總額	1,265,956	1,267,152	1,213,861
流動資產			
存貨	132,924	127,997	115,500
貿易應收款項及應收票據	124,932	121,528	110,624
預付款項、按金及其他應收款項	7,185	11,346	12,943
應收關聯方款項	50,228	51,496	46,217
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	775,311	190,134	-
已凍結存款及定期存款	340	64,069	246,931
現金及現金等價物	284,280	836,722	243,853
流動資產總額	1,375,200	1,403,292	776,068
流動負債			
貿易應付款項	68,632	66,561	66,978
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	140,159	143,445	114,707
計息銀行借款	60,521	60,694	4,219
政府補助	43,722	42,205	41,572
應付關聯方款項	14,868	19,055	14,264
應付所得稅	27,015	18,888	23,806
流動負債總額	354,917	350,848	265,546
流動資產淨額	1,020,283	1,052,444	510,522
總資產減流動負債	2,286,239	2,319,596	1,724,383
非流動負債			
計息銀行借款	28,346	29,471	90,061
遞延稅項負債	13,096	8,855	9,952
非流動負債總額	41,442	38,326	100,013
淨資產	2,244,797	2,281,270	1,624,370
權益和負債權益			
股本	1,559,054	1,558,999	1,550,820
儲備	147,552	165,406	73,550
本公司擁有人應佔權益	1,706,606	1,724,405	1,624,370
非控股權益	538,191	556,865	-
權益總額	2,244,797	2,281,270	1,624,370

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	64,468	49,070	59,298
折舊及攤銷	30,429	27,717	29,436
應佔聯營公司溢利	(453)	(1,248)	(4,708)
營運資金的變動及其它	(21,475)	(145)	(32,073)
經營活動所得現金流量淨額	72,969	75,394	51,953
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房及設備項目	(62,027)	(33,757)	(28,885)
其他投資活動所用現金流量	(538,187)	(42,918)	(126,203)
投資活動所用現金流量	(600,214)	(76,675)	(155,088)
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益資本注資	-	-	377,000
發行股份所得收益	627	-	620
向股東支付股息	(13,851)	(19)	(27,221)
已凍結存款的減少/(增加)	13,851	19	(13,867)
償還銀行貸款	-	-	(2,267)
已付利息	(487)	(556)	(742)
融資活動所得/(用)現金流量	140	(556)	333,523
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(527,105)	(1,837)	230,388
外匯匯率變動影響淨額	(25,337)	4,253	(11,327)
期初現金及現金等價物	836,722	241,437	617,661
期末現金及現金等價物	284,280	243,853	836,722

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

杜洋

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一八年十一月八日